



持續創新改善 全員追求卓越

# 法人說明會

股票代號：6207

2024/12/18

LASER TEK, TAIWAN CO., LTD.

# 免責聲明

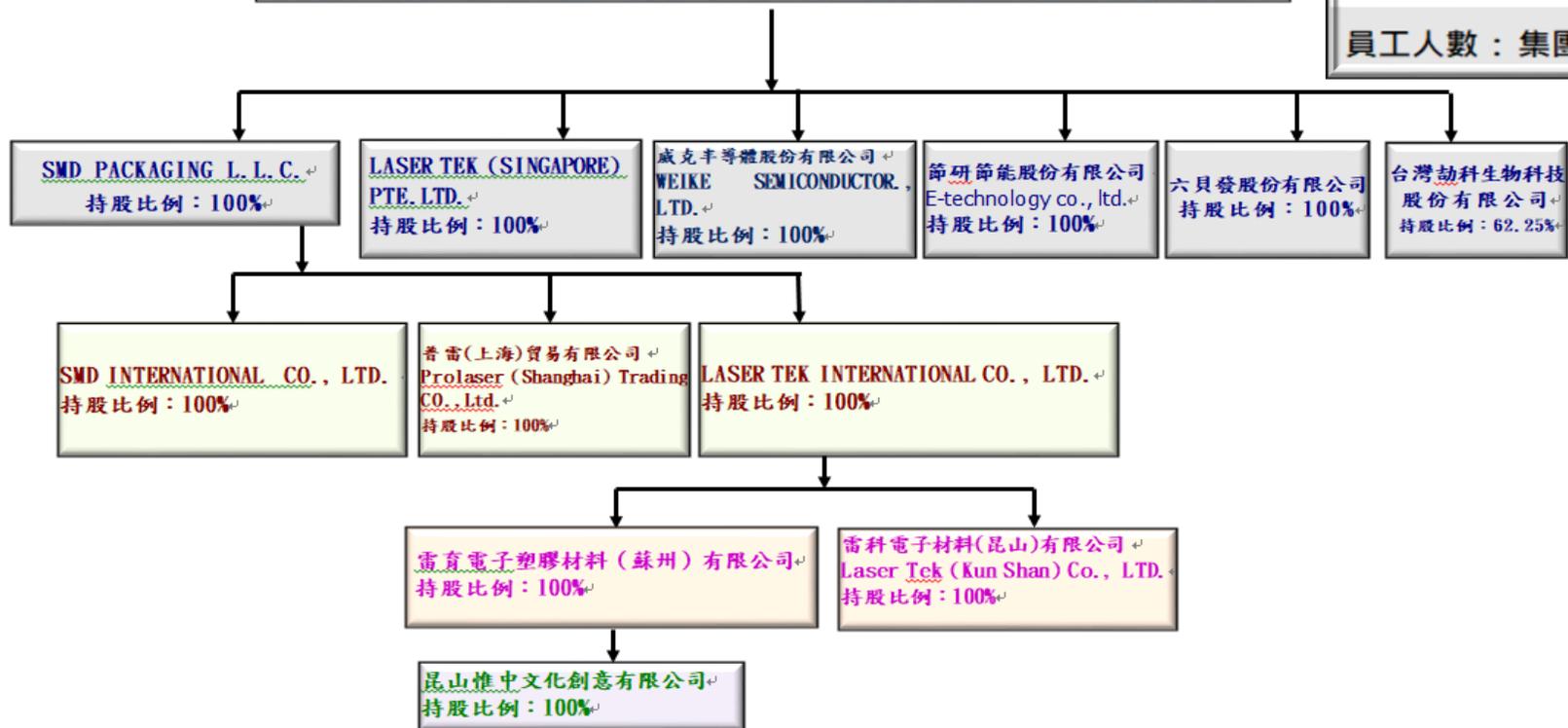
本報告內容係依現有資訊而做成，上述說明中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響，致使最後結果與原先的說明迥異，是以本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。



# 公司組織簡介

LASERTEK TAIWAN CO., LTD. 雷科股份有限公司

公司名稱：雷科股份有限公司  
成立日期：1988年9月9日  
資本額：新台幣796,799千元  
董事長：鄭再興先生  
員工人數：集團員工約300人



 全球佈局雷科品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案



# 雷科集團營業據點

全球佈局雷科品牌，聚焦核心光電技術  
拓展利基藍海市場，提供完整服務方案

雷科-昆  
山生產  
基地



雷科-東莞發  
貨中心



雷科-新加坡



新竹分公司



高雄臨廣總公司



高雄新生大樓



# 雷科產品事業群



## 設備事業 ( Laser & Metrology Equipments )

LASER 製程、檢測設備

COWOS 設備



## SMD捲裝材料事業 ( Surface Mount Device Packaging Materials )

被動元件 捲裝材料

半導體元件 捲裝材料



## 能源事業 / GERMAGIC防疫系列產品

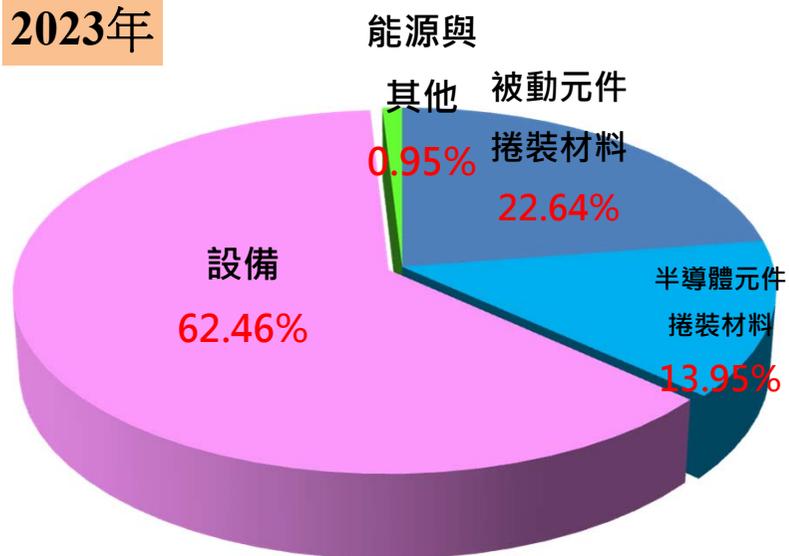
太陽能相關

空氣清淨機

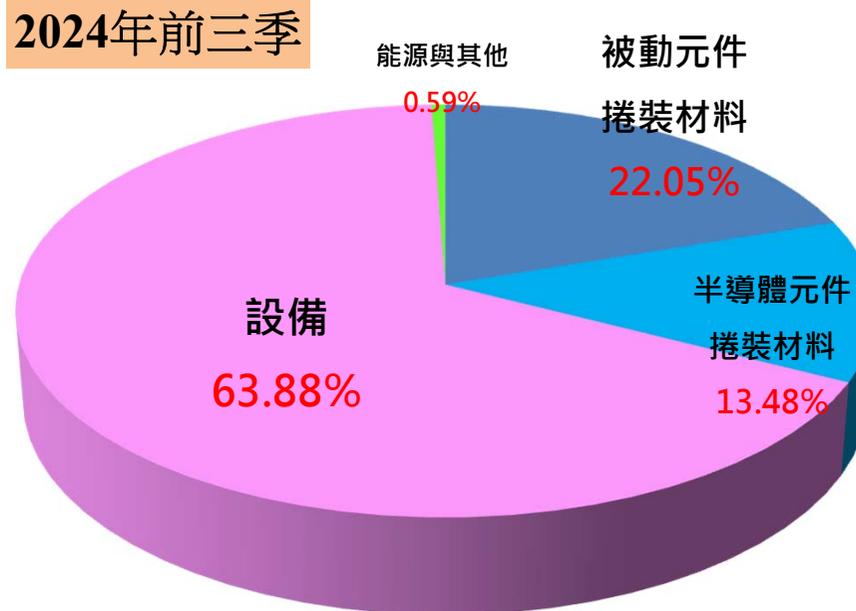
GERMAGIC防疫產品

# 公司產品項目佔比

2023年

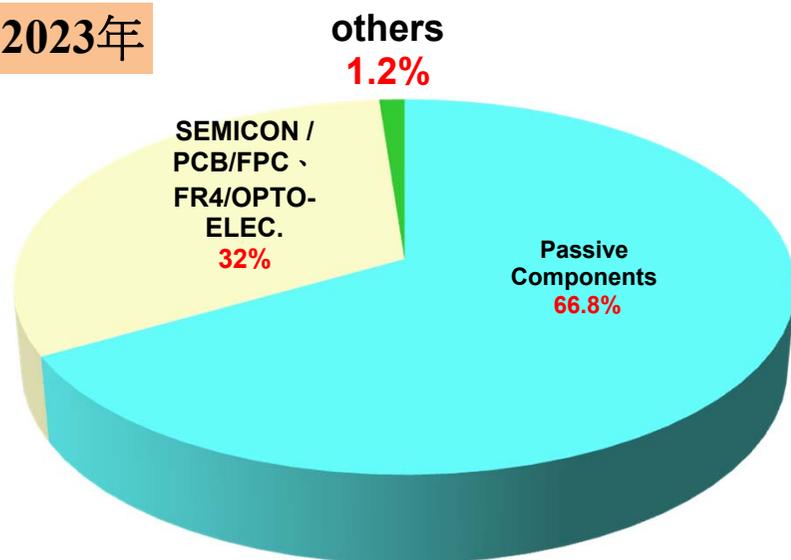


2024年前三季

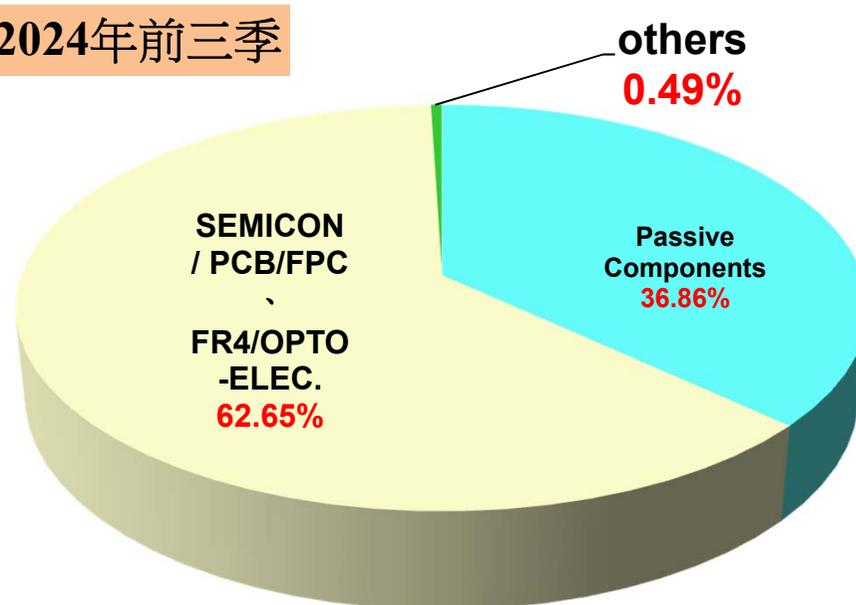


# 產品產業別佔比

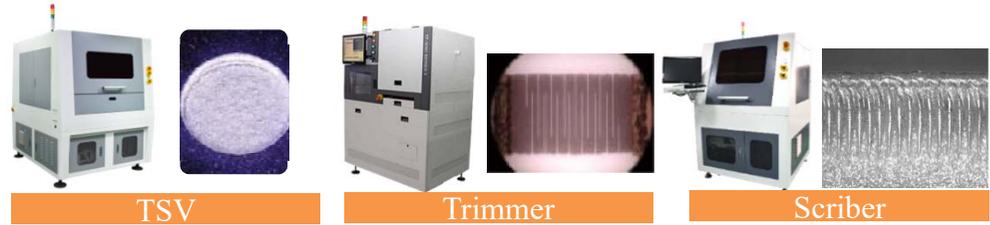
2023年



2024年前三季

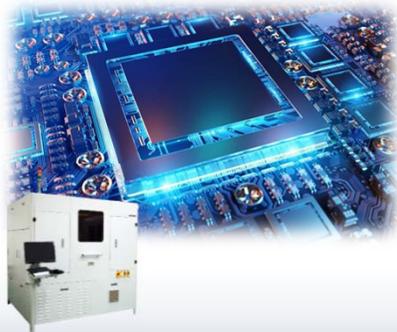


# 設備部門產品介紹與應用



## 四大核心領域

### 半導體



- Wafer trim
- CoWoS
- TSV
- SIC cutting
- FOPLP

### 載板



- FR4車用電子
- RF高頻散熱載板
- 5G高頻元件

### 元件



- Thick film
- Thin film(高精度)
- Functional trim

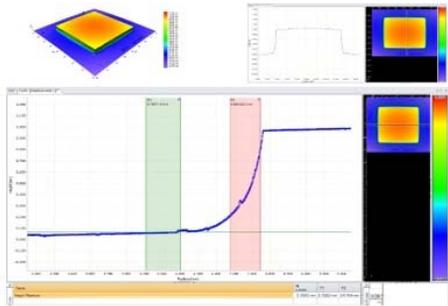
### AI應用



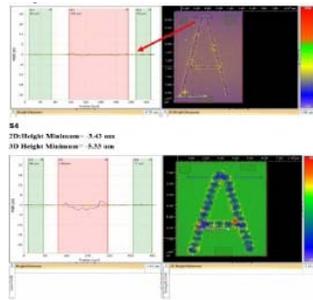
- AI 缺陷檢查
- AI 鑽石切割
- VR 智慧切割
- AI GPU除膠



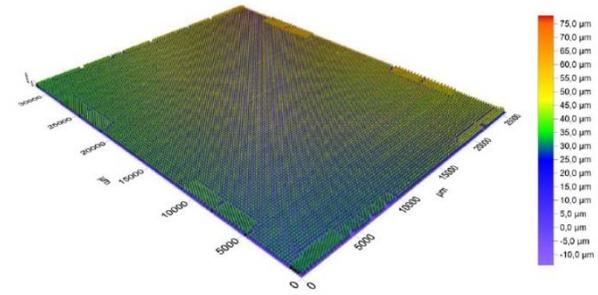
# 半導體領域 CoWoS 封裝設備



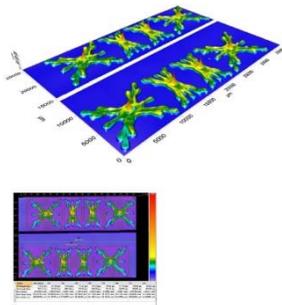
▲ UNDER-FILL GLUE FILLET HEIGHT



▲ LASER SCRIBING

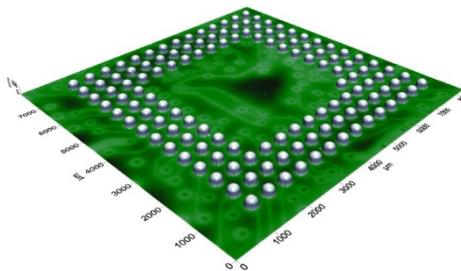


▲ C4 bump height ,diameter & warpage measurement (substrate surface side) by L-CHR

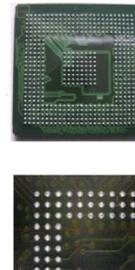


▲ SOLDER DISPENSED

Surface image of a Micro BGA



▲ HEIGHT, COPLANARITY –BGA SOLDER BUMPS



- CTWL200D
- CT350T
- CT450T
- CT600T
- (TTV)



- CT350
- CT450
- CT600



# 半導體領域 雷射相關設備--- 前段切割鑽孔/中段測試/後段封裝

## 晶圓製造

### TSV 飛秒鑽孔機



特殊光學套件，進行矽晶圓穿孔與盲孔冷加工

### Cyber 設備



高階 2D/3D 非接觸式雷射掃描設備

## 中段測試

### Wafer trim



半導體晶圓修調，On Line 在線即時量測與修調

### Functional trim



混成電路 IC 功能修調，高精度量測，精密修調

## 後段封裝

### FR4 cutting



封測產品切粒，Sorter 收料，自動化流水線

### Laser Deflash



Lead frame 修整去毛邊，四點對位漲縮補償

### SIC 飛秒切割機



特殊光學套件，進行 SIC 剝蝕冷加工切割

### Wafer marking



IC Marking，Wafer Marking

### FOPLP



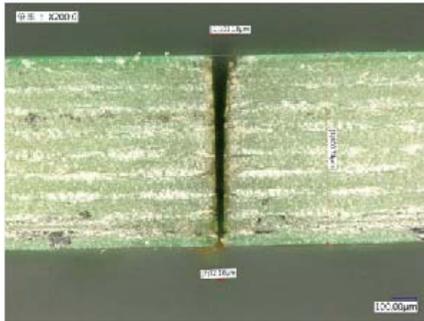
玻璃基板去除膠體



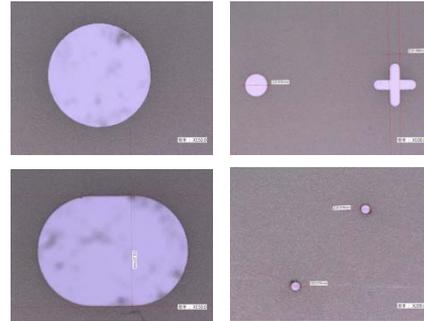


## 載板應用

雷射應用相關設備--- 高階半導體封裝載板/軟硬複合板



車用電子載板  
載板切割應用



高頻RF散熱載板  
低軌衛星(LEO)應用



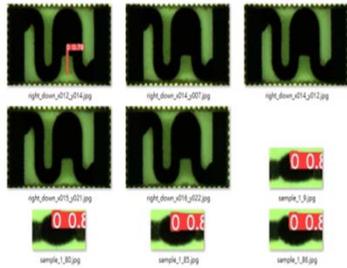
高精度複合板切割  
消費電子板材



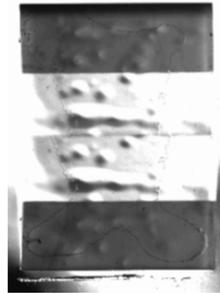


# AI智慧應用

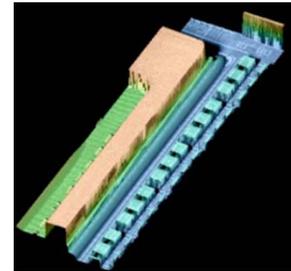
## 雷射應用相關設備--- AI+AOI+雷射



**AI缺陷檢查**  
各類元件雷射應用



**AI 透明輪廓建構**  
VR/AR 玻璃切割應用



**AI 膠體高度輪廓**  
AI晶片除膠應用

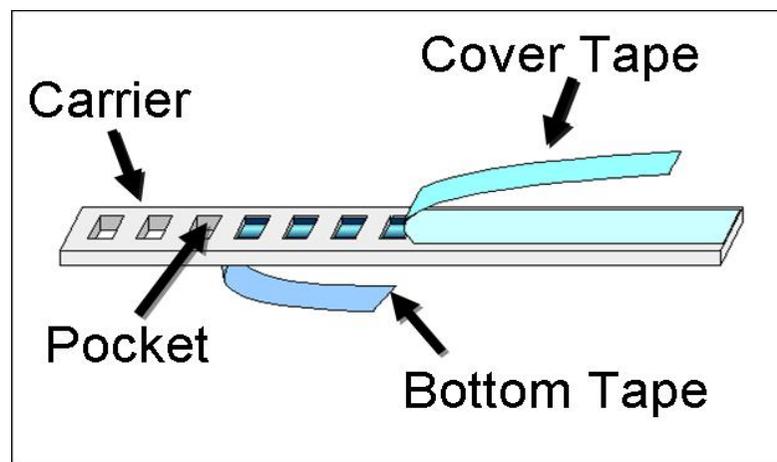


**AI視覺辨識**  
光反材質雷射應用



## ➤ SMD 捲裝材料事業 ( Surface Mount Device Packaging Materials )

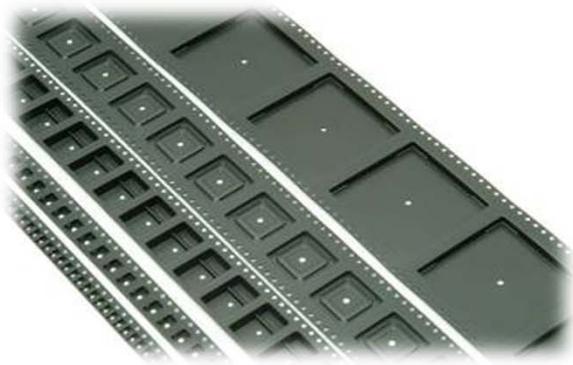
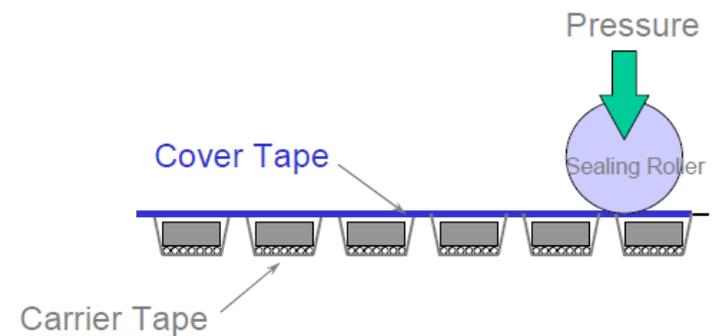
### 被動元件 捲裝材料



## ➤ SMD 捲裝材料事業 (Surface Mount Device Packaging Materials)

### 半導體 捲裝載帶

- Carrier Tape 為：IC 半導體、電子被動元件、LED 產品等包裝捲帶，其材質最主要為 PC、PS ... 等塑膠原料。



# 2024年前三季營運成果

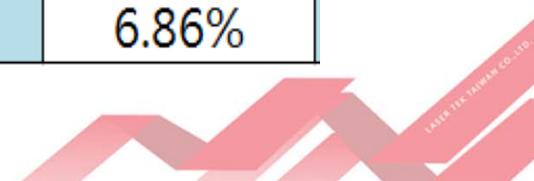
 **LASERTEK** 全球佈局雷射品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案



# 綜合損益表

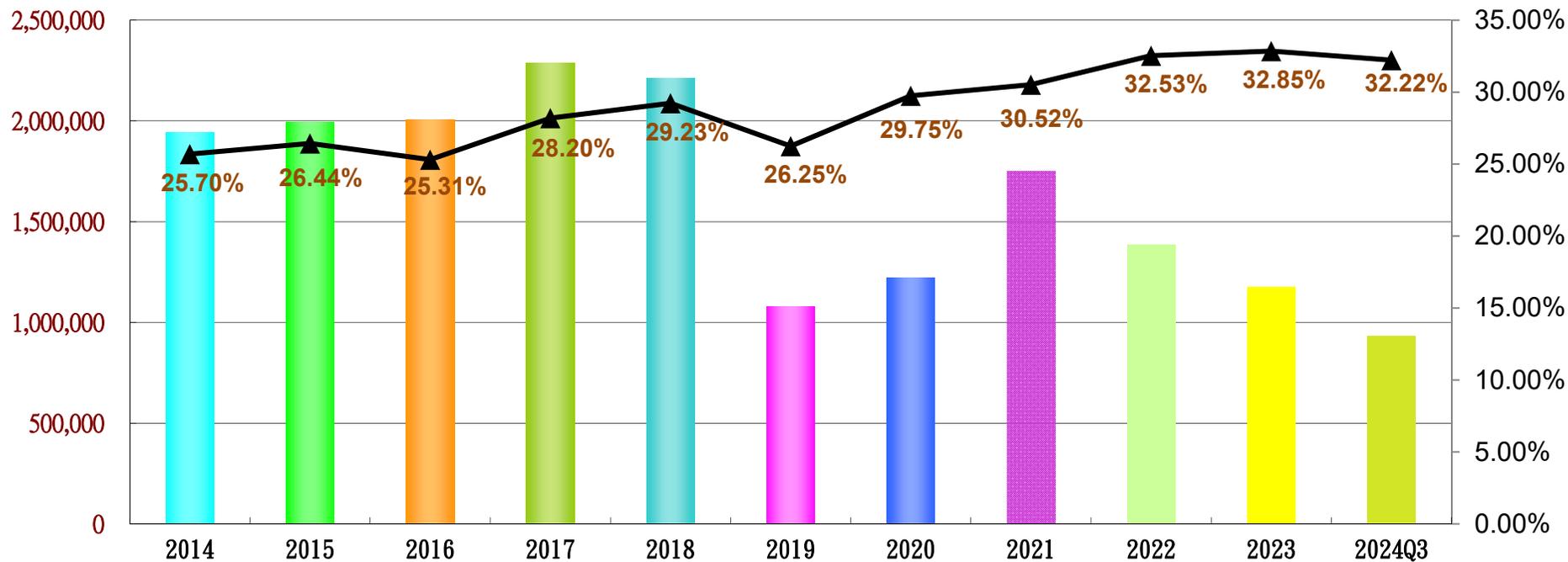
單位：新台幣仟元

項目	2024 3Q	2023 3Q	年差異%
營業收入淨額	935,808	776,739	20.48%
營業毛利率	32.22%	30.63%	5.19%
營業費用	239,291	216,652	10.45%
營業淨利(損)	62,262	21,266	192.78%
營業淨利率	6.65%	2.74%	142.70%
營業外收入及支出	90,656	122,305	-25.88%
歸屬於母公司業主之本期淨利(損)	127,891	115,371	10.85%
純益率	13.62%	14.85%	-8.28%
每股盈餘(新台幣元)	1.61	1.45	11.03%
股東權益報酬率	6.85%	6.41%	6.86%



# 近10年集團營收與毛利率

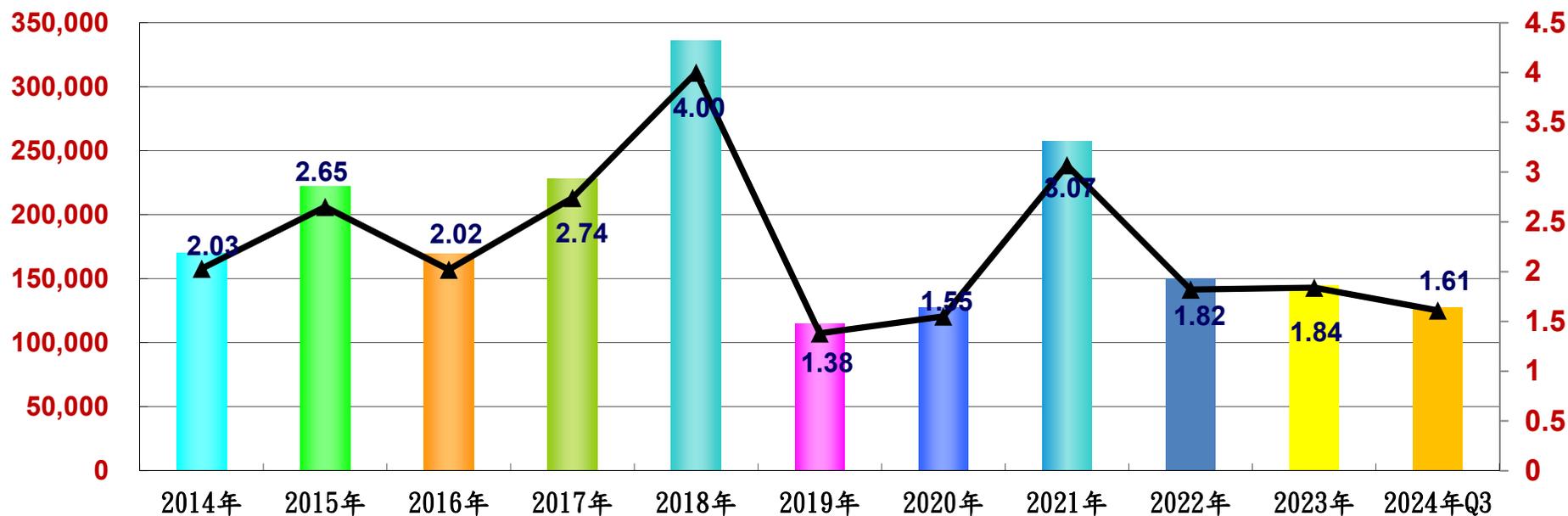
單位：新台幣仟元



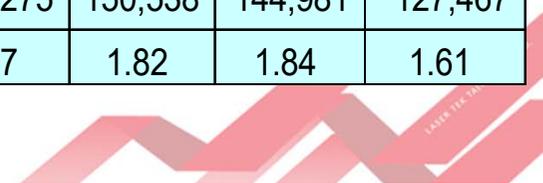
年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024Q3
集團營收	1,941,943	1,995,668	2,004,536	2,287,415	2,211,070	1,078,330	1,221,008	1,751,466	1,386,770	1,177,816	935,808
集團毛利率	25.70%	26.44%	25.31%	28.20%	29.23%	26.25%	29.75%	30.52%	32.53%	32.85%	32.22%

# 集團稅後損益與EPS

單位：新台幣仟元/元



	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年Q3
稅後損益	170,007	222,256	169,726	228,105	335,810	114,914	127,264	257,275	150,538	144,981	127,467
EPS	2.03	2.65	2.02	2.74	4.00	1.38	1.55	3.07	1.82	1.84	1.61





持續創新改善 全員追求卓越

# 感謝您的蒞臨

Thank you for coming here today.

LASER TEK, TAIWAN CO., LTD.